

11月1日(水)10:00-12:25	コース	11月1日(水)14:00-16:40	11月2日(木)12:50-15:05	11月2日(木)15:35-17:50
<p>KM-1 挨拶・基調講演 10:00-12:25</p> <p>◆来賓挨拶 京都府知事 山田 啓二(予定) 京都市長 門川 大作(予定)</p> <p>◆基調講演「IoT社会の可能性を切り拓く イメージセンサーの展望と課題」 ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱ 代表取締役社長 清水 照士</p> <p>◆基調講演「今日のデータセンターの現状と課題(仮題)」 特定非営利活動法人日本データセンター協会 理事長 白川 功</p> <p>◆基調講演「オムロン企業理念と新中期経営計画 VG (Value Generation) 2.0」 オムロン㈱ 取締役 執行役員 専務 CFO兼グローバル戦略本部長 日戸 興史</p> <p>◆基調講演「半導体100兆円の時代がやってきた!! ~フラッシュメモリ、各種センサー製造装置で示す 日本企業の存在感」 ㈱産業タイムズ社 代表取締役社長 泉谷 渉</p>	<p>【A】 次世代 自動車</p> <p>【B】 次世代 IoTデバイス</p>	<p>A-1 自動運転 松浦正純(ルネサス)/山崎治(シャープ)</p> <p>◆自動運転のマーケット(仮題) 株式会社野村総合研究所インダストリアルテクノロジーユニット自動車産業ユニット プロジェクトマネージャー 池山 智也</p> <p>◆人と車の融和を推進するドライバー理解技術 オムロン㈱技術・知財本部センシング研究開発センター 画像センシング研究室 主査 相澤 知禎</p> <p>B-1 応用 岡田吉生(GF)/小田川明弘(パナソニック)</p> <p>◆水中ロボットによるダムインフラ維持管理 パナソニック㈱コネクティッドソリューションズ社イノベーションセンター メカトロソリューション開発部 部長 九郎丸 俊一</p> <p>◆IoTとセンサが活躍する次世代農業 ベンジャリア㈱ 代表取締役社長 小池 聡</p> <p>◆VR関連デバイスの最新動向 HTC NIPPON㈱ Director of Sales Operation, VIVE JAPAN 西川 美優</p>	<p>A-2 電動車 山崎治(シャープ)/松浦正純(ルネサス)</p> <p>◆次世代自動車の市場展望 ~自動車パワートレインの長期見通しと自動運転による市場創造~ カノラマジパン㈱代表取締役 宮尾 健</p> <p>◆日産ノートe-POWERの開発 日産自動車㈱パワートレイン技術開発本部 パワートレイン主管 仲田 直樹</p> <p>B-2 デバイス 宮崎信(村田製作所)/酒井滋樹(日新イオン機器)</p> <p>センサ等のIoTを支えるデバイスを選定中</p>	<p>A-3 車載キーデバイス 中村孝(ローム)/佐藤高史(京都大学)</p> <p>◆ルネサスが描く次世代自動車の最先端半導体技術と未来への取り組み ルネサス エレクトロニクス㈱オートモティブソリューション事業本部 技師長 板垣 克彦</p> <p>◆車載イーサネット(仮題) ㈱メガチップス ASSP事業本部高速有線通信事業部 事業部長 金銅 恒</p> <p>◆SiCパワーデバイスの現状 ローム㈱パワーデバイス生産本部ハイパワーデバイス製造部商品企画G グループリーダー 三浦 峰生</p> <p>B-3 次世代技術 重松智志(NTT)/佐々木元(メガチップス)</p> <p>◆極低電力LSIデバイス(SOTB)の最新技術 ルネサス エレクトロニクス㈱ 生産本部 デバイス開発統括部 先端デバイス開発部 部長 山口 泰男</p> <p>◆半導体材料を用いた人工光合成技術の最新動向と展望 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 太陽光発電研究センター 主席研究員 佐山 和弘</p> <p>◆LoRaデバイス(仮題) ㈱ソラコム テクノロジー・エンジニアリスト 事業開発マネージャー 松下 亮平</p>
<p>11月2日(木)9:30-11:55</p> <p>KM-2 マーケティングセッション 9:30-11:55</p>	<p>【C】 メモリー 新時代到来</p> <p>【D】 特別セッション 産学連携 & パッケージ</p>	<p>C-1 材料・装置 藤原健典(東レ)/酒井滋樹(日新イオン機器)/不破保博(ローム)</p> <p>◆3次元構造メモリの製造プロセスを支えるドライエッチング技術 東京エレクトロン㈱ エッチングシステムマーケティング部 Market Analyst 道順 麻貴子</p> <p>◆次世代IoTクラウド社会を実現する高密度実装線順 TSVプロセス・装置の新提案 ㈱アルバック 半導体電子技術研究所 第3研究部 第1研究室 室長 森川 泰宏</p> <p>◆低線膨張銅めっき液の特性と事業化 大阪府立大学 微小めっき研究所 所長 教授 近藤 和夫</p> <p>D-1 大学セッション(無料) ナノテクノロジープラットフォーム 戸所義博(奈良先端大)</p> <p>◆アモルファス酸化物半導体の熱電デバイス応用について 奈良先端科学技術大学院大学 物質創生化学研究科 助教 上沼 睦典, 教授 浦岡 行治</p> <p>◆シリウムイオン顕微鏡を用いたナノ加工と評価 大阪大学 産業科学研究所 特任助教 法澤 公寛</p> <p>◆ナノインプリントによる金属ナノシリンドラー周期アレイの 作製と光学特性 京都大学 工学研究科 助教 村井 俊介</p>	<p>C-2 デバイス・応用① 廣田良浩(東京エレクトロン)/山本浩之(マイクロン)/小田川明弘(パナソニック)/戸所義博(奈良先端大)</p> <p>◆超大容量ストレージを実現する3次元フラッシュメモリ (BiCS FLASH™)技術 東芝メモリ(株) 先端メモリ開発センター 技監 青地 英明</p> <p>◆Micron 3D NAND and 3DXPoint Products Outline マイクロンジャパン㈱ストレージ・ビジネス・ユニット シニア・マーケティング・マネージャー 服部 昇</p> <p>◆データセンタの最新動向とデータセンタ内のICT装置・半導体に 求められる要件 富士通㈱サービスプラットフォーム戦略企画室エグゼクティブアーキテクト 大阪大学 次世代クラウド協働研究所 副所長 藤巻 秀明</p> <p>D-2 パッケージング① 藤原健典(東レ)/岡田吉生(GF)</p> <p>◆進化するFO-WLPテクノロジーと適用アプリケーション ㈱SBRテクノロジー 代表取締役 西尾 俊彦</p> <p>◆半導体パッケージ基板用絶縁材料技術 味の素㈱バイオ・ファイン研究所 素材・用途開発研究所 素材開発研究室長 中村 茂雄</p> <p>◆パナソニックのモールド樹脂材料技術(仮題) パナソニック㈱ オートモティブ&インダストリアルシステム社 電子材料事業部技術開発センター先端材料開発部 主任技師 岩谷 絵美</p>	<p>C-3 デバイス・応用② 小田川明弘(パナソニック)/戸所義博(奈良先端大)</p> <p>◆メモリ新時代到来! ~いつまでも"新世代"ではられない~ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹 秋永 広幸</p> <p>◆ReRAM基本技術とその研究開発最新動向 ~微細化/3次元化/脳型チップ応用など~ パナソニック・センタック・テクノロジー・ソリューションズ ㈱ 半導体ビジネスユニット マネージャ/技術センター ReRAM技術担当主幹 三河 巧</p> <p>◆薄膜誘電体メモリ関連(仮題) 東京大学生産技術研究所 情報・エレクトロニクス系部門 准教授 小林 正治</p> <p>D-3 パッケージング② 山本浩之(マイクロンジャパン)/廣田良浩(東京エレクトロン)</p> <p>◆これからの実装技術~実装技術ロードマップ~(仮題) (一社)日本電子情報産業協会 日本実装技術ロードマップ専門委員会 電子デバイスパッケージングWG 副主査 杉崎 吉昭</p> <p>◆DNP実装技術関連(仮題) 大日本印刷㈱ (講師依頼中)</p>
<p>司会:松下晋司(㈱産業タイムズ社)</p> <p>◆特別講演「IoT産業の最前線の最新動向(仮題)」 IHS グローバル㈱ 調査部ディレクター 南川 明</p> <p>◆特別講演「半導体産業と製造装置産業 の最新動向(仮題)」 野村證券㈱エクイティ・リサーチ一部 マネージング・ディレクター 和田木 哲哉</p> <p>◆特別講演「更に揺れるFPD業界、 LCD/OLED/新技術?、業界再編の鍵を握るのは?」 みずほ証券㈱エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・ テクノロジー・リサーチ シニアアナリスト 中根 康夫</p>	<p>【E】 特別セッション 有機EL & アナログパワー</p>	<p>E-1 アナログ(パワー)回路入門 佐藤高史(京都大学)/中村孝(ローム)</p> <p>◆パワーエレクトロニクスの基礎と先端材料・回路応用技術 大阪大学大学院 工学研究科 電気電子情報工学専攻 システム・制御工学講座 パワースystem領域 教授 舟木 剛</p> <p>◆E級スイッチング回路と高周波数無線電力伝送システム 千葉大学大学院工学研究科 教授 関屋 大雄</p>	<p>E-2 有機EL① 重松智志(NTT)/中村孝(ローム)</p> <p>◆高効率運延蛍光材料及びOLEDの最前線 九州大学 工学研究院 応用化学部門 教授 最先端有機エレクトロニクス研究センター 長 安達 千波矢</p>	<p>E-3 有機EL② 宮崎信(村田製作所)/不破保博(ローム)</p> <p>◆有機ELディスプレイ産業の最新動向(仮題) ディスプレイライフェンコンサルティングDSCC アジア代表 田村 喜男</p>